1. 有關本集團的進一步資料

註冊成立

本公司的前身公司江蘇芯德半導體科技有限公司於2020年9月11日於中國成立為有限責任公司。於2024年6月27日，本公司根據適用中國法律法規由有限責任公司改制為股份有限責任公司，並更名為江蘇芯德半導體科技股份有限公司。我們的註冊辦事處位於中國南京市浦口區浦口經濟開發區林春路8號。

我們已設立香港營業地點，地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座31樓，並於2025年10月24日根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。達盟香港有限公司的葉嘉紅女士獲委任為本公司授權代表，以代表本公司於香港接收法律程序文件及通知。本公司於香港接收法律程序文件的地址即上文所載的香港主要營業地點。

由於本公司在中國成立，故我們須遵守相關中國法律法規。有關中國法律法規的相關方面以及公司章程的概要分別載於本文件「法規」及附錄五。

本公司的股本變動

除「歷史、發展及公司架構」所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

附屬公司的股本變動

我們的附屬公司載於會計師報告，請參閱「附錄一－會計師報告」。除「附錄一－會計師報告」所提及的附屬公司外，本公司概無其他附屬公司。除上文及「歷史、發展及公司架構」所披露者外，附屬公司的註冊資本於緊接本文件日期前兩年內並無其他變動。

股東通過的決議案

於2025年10月13日舉行的股東特別大會上，股東通過下列決議案（其中包括）：

(i) [**編纂**]每股面值人民幣1.00元的H股，並使該等H股在聯交所[**編纂**]；

(ii) 根據[**編纂**]將予[**編纂**]的H股，並授予[**編纂**]的[**編纂**]（或其代表）不多於根據[**編纂**][**編纂**]的H股數目的[**編纂**]；

(iii) 待向中國證監會完成備案後，於[**編纂**]完成後，股東合共持有的[**編纂**]股非上市股份將按一兑一基準[**編纂**]為H股；

(iv) 待[**編纂**]完成後，批准及採納公司章程，其將於[**編纂**]生效，並授權董事會根據相關監管機關的任何意見對公司章程進行必要的修訂；及

(v) 批准董事會及董事會授權的人士處理有關（其中包括）H股於聯交所[**編纂**]及[**編纂**]的所有事宜。

重組

我們並無就[**編纂**]進行任何公司重組。有關本公司歷史及發展的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構」。

2. 有關我們業務的進一步資料

重大合約概要

在緊接本文件日期前兩年內，我們訂立了以下屬於或可能屬於重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

(i) [**編纂**]。

知識產權

商標

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的知識產權：

商標	註冊地點	註冊編號	類別	屆滿日期
CAPiC	中國	70402212	40	2033年9月20日
CAPiC	中國	70095085	40	2033年8月27日
芯德	中國	70098973	40	2033年8月27日
XD-HPFO	中國	60091353	40	2032年5月6日
XD-HPFO	中國	60099046	42	2032年4月27日
XD-HPFO	中國	60085397	9	2032年5月6日
JSSISEMI	中國	59650278	40	2032年3月20日
	中國	59645130	40	2032年3月13日
JSSISEMI	中國	50824487	42	2031年8月6日
JSSISEMI	中國	50847303	9	2031年7月6日
	中國	50828235	42	2031年8月20日
	中國	50643245	9	2031年10月6日
JSSI semi 芯德半导体	香港	307018353	9、35、40、42	2035年9月3日

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊或獲授權使用下列我們認為對我們的業務而言屬重大的域名：

域名	註冊擁有人	屆滿日期
jssisemi.com.cn	本公司	2033年1月27日
jssisemi.com	本公司	2032年9月28日
jssisemi.cn	本公司	2032年11月4日

版權

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的版權：

版權名稱	註冊地點	註冊編號	首次公佈日期
上崗考核管理系統	中國	2023SR0743250	2023年6月28日
WMS倉庫管理系統	中國	2023SR0421217	2023年3月30日
異常偵測與分類系統	中國	2022SR1341662	2022年9月2日
統計過程控制系統	中國	2021SR1591735	2021年10月29日
品質異常處理系統	中國	2021SR1553839	2021年10月25日
光罩掩膜版管理系統	中國	2021SR1532382	2021年10月20日
電子化保養系統	中國	2021SR1534638	2021年10月20日
設備自動化作業控制系統	中國	2021SR1342437	2021年9月8日
芯德設備程序管理系統	中國	2021SR0881304	2021年6月11日

專利

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的專利：

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種真空包裝機的加熱條收緊裝置.....	中國	CN202422227269.5	本公司	實用新型	2024年9月11日
一種通孔基板的雙面封裝混合芯片結構.....	中國	CN202422489687.1	本公司	實用新型	2024年10月15日
一種倒裝芯片吸附裝置.....	中國	CN202422232500.X	本公司	實用新型	2024年9月12日
一種貼散熱蓋的倒裝芯片封裝結構.....	中國	CN202422356795.1	本公司	實用新型	2024年9月26日
一種集成電容與PMIC芯片的高密度堆疊封裝結構及封裝方法.....	中國	CN202510652690.7	本公司	發明專利	2025年5月21日
一種濾波器模組的封裝結構及其製造方法...	中國	CN202211122369.0	本公司	發明專利	2022年9月15日
一種自動定位片匣尺寸平台裝置.....	中國	CN202422389076.X	本公司	實用新型	2024年9月29日
一種晶圓定位治具	中國	CN202420650159.7	本公司	實用新型	2024年4月01日
一種具有雙封裝體的半導體封裝結構	中國	CN202422721183.8	本公司	實用新型	2024年11月08日

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種電路控制芯片封裝結構...	中國	CN202422150192.6	本公司	實用新型	2024年9月02日
一種嵌入式晶片級球柵陣列鍵合工藝中避免分層的方法.....	中國	CN202510541161.X	本公司	發明專利	2025年4月28日
一種超窄間距PI層開口方法及半導體封裝結構	中國	CN202210549652.5	本公司	發明專利	2022年5月20日
一種測量晶圓工作台與頂針帽高度的治具.....	中國	CN202422222993.9	本公司	實用新型	2024年9月10日
一種佈線圖紙設計自動化軟件系統及設計方法.....	中國	CN202111663523.0	本公司	發明專利	2021年12月30日
一種全方位檢測半導體封裝產品的治具.....	中國	CN202421662953.X	本公司	實用新型	2024年7月12日
一種散熱蓋活動料倉	中國	CN202421843754.9	本公司	實用新型	2024年7月31日
一種便攜式芯片運輸提籃.....	中國	CN202421750611.3	本公司	實用新型	2024年7月23日
一種晶圓表面具有再鈍化層的凸塊高度測量方法...	中國	CN202211695534.1	本公司	發明專利	2022年12月28日

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種扇出型芯片封裝結構.....	中國	CN202420814100.7	本公司	實用新型	2024年4月18日
一種芯片超薄封裝載板及芯片封裝結構和芯片封裝方法.....	中國	CN202210485627.5	本公司	發明專利	2022年5月06日
一種對貼片環固定膠膜的裝置.....	中國	CN202420650143.6	本公司	實用新型	2024年4月01日
一種改善溢膠的芯片結構及其裸露芯片封裝結構.....	中國	CN202420321053.2	本公司	實用新型	2024年2月20日
一種電鍍線導電塊自動夾緊裝置	中國	CN202421398686.X	本公司	實用新型	2024年6月19日
一種TCB多孔放置工具.....	中國	CN202421371175.9	本公司	實用新型	2024年6月17日
一種正面保護的晶圓級芯片封裝結構.....	中國	CN202420816705.X	本公司	實用新型	2024年4月18日
一種芯片封裝結構 .	中國	CN202421242815.6	本公司	實用新型	2024年6月03日
一種電鍍機卡盤導向柱.....	中國	CN202420501114.3	本公司	實用新型	2024年3月15日
一種芯片疊層封裝結構.....	中國	CN202420494637.X	本公司	實用新型	2024年3月14日
一種芯片吸嘴及其組成的芯片焊接裝置...	中國	CN202420485417.0	本公司	實用新型	2024年3月13日

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種防摔料裝置及其組成的連線機.....	中國	CN202323367008.5	本公司	實用新型	2023年12月11日
一種焊線機台快速冷卻裝置...	中國	CN202421058949.2	本公司	實用新型	2024年5月15日
一種提高倒裝方形扁平無引腳封裝產品散熱性的封裝結構.....	中國	CN202420002729.1	本公司	實用新型	2024年1月02日
一種防止晶粒黏貼膠溢出的鍍銀框架及其組成的封裝結構.....	中國	CN202420036907.2	本公司	實用新型	2024年1月08日
一種單顆芯片產品載具定位檢測裝置.....	中國	CN202421150985.1	本公司	實用新型	2024年5月24日
一種自動檢驗彈夾裝置.....	中國	CN202420300156.0	本公司	實用新型	2024年2月19日
一種適用於底部填充的加熱平台裝置.....	中國	CN202420188709.8	本公司	實用新型	2024年1月26日
一種超聲波掃描載具台及焦距快速確定方法...	中國	CN202211131176.1	本公司	發明專利	2022年9月16日
一種包含雙重佈線層的芯片堆疊結構.....	中國	CN202421054470.1	本公司	實用新型	2024年5月15日

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種實現MEMS芯片互聯的扇出型晶圓級封裝結構.....	中國	CN202421024469.4	本公司	實用新型	2024年5月11日
一種光刻版保護膜貼膜治具.....	中國	CN202420754611.4	本公司	實用新型	2024年4月12日
一種分選機防卡料裝置.....	中國	CN202323529869.9	本公司	實用新型	2023年12月25日
一種改善晶粒黏貼膜分層的環鍍銀框架.....	中國	CN202323529848.7	本公司	實用新型	2023年12月25日
一種濺射工藝穩定性評估方法.....	中國	CN202211696268.4	本公司	發明專利	2022年12月28日
一種UV膜劃膜裝置	中國	CN202420821820.6	本公司	實用新型	2024年4月19日
適用於等離子清洗機的防電弧產生裝置.....	中國	CN202420565134.7	本公司	實用新型	2024年3月22日
一種扇出型封裝方法及扇出型封裝結構.....	中國	CN202111358610.5	本公司	發明專利	2021年11月16日
一種倒裝機鋼嘴頭的自動清潔裝置.....	中國	CN202420050924.1	本公司	實用新型	2024年1月09日
一種能夠預防回流偏移的回流機...	中國	CN202323575466.8	本公司	實用新型	2023年12月27日
一種快速識別坐標託盤.....	中國	CN202420772165.X	本公司	實用新型	2024年4月15日

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
減薄倒裝產品厚度的封裝結構.....	中國	CN202322628825.5	本公司	實用新型	2023年9月26日
一種晶圓切割刀片	中國	CN202420501123.2	本公司	實用新型	2024年3月15日
一種掛鍍式電鍍機清洗槽.....	中國	CN202420378456.0	本公司	實用新型	2024年2月29日
一種自適應多種厚度塑封模具...	中國	CN202420334682.9	本公司	實用新型	2024年2月23日
一種提高FCBGA封裝平整度的散熱蓋及其組成的封裝結構.....	中國	CN202323459970.1	本公司	實用新型	2023年12月19日
一種能夠提高封裝平整度的散熱蓋.....	中國	CN202323327111.7	本公司	實用新型	2023年12月07日
一種應用於超薄芯片編帶的撿取吸嘴連桿...	中國	CN202420019775.2	本公司	實用新型	2024年1月04日
一種具有散熱和電磁屏蔽功能的封裝結構及封裝方法.....	中國	CN202411018538.5	本公司	發明專利	2024年7月29日
一種倒裝芯片封裝結構用框架及其芯片封裝結構...	中國	CN202323499007.6	本公司	實用新型	2023年12月21日

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種超大尺寸的散熱蓋及使用散熱蓋的半導體封裝結構.....	中國	CN202323393783.8	本公司	實用新型	2023年12月12日
一種垂直混裝芯片封裝結構...	中國	CN202323494085.7	本公司	實用新型	2023年12月21日
一種含高中低密度芯片的封裝結構.....	中國	CN202323299000.X	本公司	實用新型	2023年12月04日
一種新型基板真空墊塊.....	中國	CN202323171190.7	本公司	實用新型	2023年11月23日
具有電磁屏蔽功能的封裝結構.	中國	CN202322979032.8	本公司	實用新型	2023年11月03日
一種新型測量膠重量杯.....	中國	CN202323010782.0	本公司	實用新型	2023年11月08日
一種CVS分析儀加液裝置.....	中國	CN202322933567.1	本公司	實用新型	2023年10月31日
一種應用於晶圓清洗的過濾裝置	中國	CN202322892332.2	本公司	實用新型	2023年10月26日
無基板高密度封裝結構.....	中國	CN202322551223.4	本公司	實用新型	2023年9月19日
具有電磁屏蔽結構的晶圓、芯片以及半導體封裝結構.....	中國	CN202322982058.8	本公司	實用新型	2023年11月03日

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種QFN產品注塑機台自動脫膜裝置.....	中國	CN202323272285.8	本公司	實用新型	2023年12月01日
一種讓注塑設備粉末樹脂均勻鋪撒的裝置.....	中國	CN202322933466.4	本公司	實用新型	2023年10月31日
一種適用於測試機上測試板的降溫裝置.....	中國	CN202322895174.6	本公司	實用新型	2023年10月27日
光電傳感器封裝結構及其製備方法.....	中國	CN202310716516.5	本公司	發明專利	2023年6月16日
一種可實現平邊晶圓校準的五角調整器裝置.....	中國	CN202322768471.4	本公司	實用新型	2023年10月16日
一種高銅柱堆疊的面對面芯片封裝結構.....	中國	CN202322982231.4	本公司	實用新型	2023年11月03日
一種倒裝芯片背面重佈線封裝結構.....	中國	CN202323025109.4	本公司	實用新型	2023年11月09日
一種自動卡控晶圓圖譜上缺陷芯片的方法.....	中國	CN202410268468.2	本公司	發明專利	2024年3月11日
一種芯片塑封模具及其二次塑封工藝方法.....	中國	CN202111372272.0	本公司	發明專利	2021年11月18日

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種雙靶材磁控濺射反應腔室...	中國	CN202322668547.6	本公司	實用新型	2023年9月28日
一種顯微鏡限位裝置.....	中國	CN202322599959.9	本公司	實用新型	2023年9月25日
一種電位滴定儀電極固定裝置...	中國	CN202322436459.3	本公司	實用新型	2023年9月08日
一種倒裝產品虛焊的檢測裝置.....	中國	CN202322245390.6	本公司	實用新型	2023年8月21日
一種激光打印設備託盤通用載具.....	中國	CN202322565333.6	本公司	實用新型	2023年9月21日
一種防晶圓甩飛的清洗腔.....	中國	CN202322418482.X	本公司	實用新型	2023年9月06日
多芯粒高密度封裝結構.....	中國	CN202322272707.5	本公司	實用新型	2023年8月23日
一種離型膜.....	中國	CN202321124902.7	本公司	實用新型	2023年5月09日
一種晶圓級超薄四邊無引腳芯片封裝方法及芯片封裝結構.....	中國	CN202311528044.7	本公司	發明專利	2023年11月16日
適用於電鍍線自動上下料的自動分批裝置...	中國	CN202322211007.5	本公司	實用新型	2023年8月17日
一種基板烘烤固定裝置.....	中國	CN202322047551.0	本公司	實用新型	2023年8月01日
一種可供劃片設備快速檢測刀架水管狀態的裝置.....	中國	CN202321296802.2	本公司	實用新型	2023年5月26日

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種具有異質膠材的晶圓級扇出型封裝結構及其封裝方法 . . .	中國	CN202311316007.X	本公司	發明專利	2023年10月12日
一種矽襯底氮化鎵晶圓的切割方法	中國	CN202311294713.9	本公司	發明專利	2023年10月09日
一種晶圓中多種芯片的圖譜合併、分發方法及系統	中國	CN202311316332.6	本公司	發明專利	2023年10月12日
一種應用於可潤濕側翼產品的切割刀片	中國	CN202321530807.7	本公司	實用新型	2023年6月15日
管腳側面上錫框架產品的切割刀片	中國	CN202321131390.7	本公司	實用新型	2023年5月11日
一種多層高密度封裝中曝光對位的工藝方法	中國	CN202311009444.7	本公司	發明專利	2023年8月11日
一種吸片頭及適配的安裝座、安裝裝置	中國	CN202320994667.2	本公司	實用新型	2023年4月27日
一種晶圓固定載具 .	中國	CN202321268159.2	本公司	實用新型	2023年5月24日
一種沖切模具推桿防呆機構 . . .	中國	CN202320994633.3	本公司	實用新型	2023年4月27日

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種異形散熱蓋及使用異形散熱蓋的半導體封裝結構.....	中國	CN202320881740.5	本公司	實用新型	2023年4月19日
自動光學檢測墊塊寬度調節裝置	中國	CN202320319353.2	本公司	實用新型	2023年2月24日
一種芯片保護封裝結構.....	中國	CN202320326250.9	本公司	實用新型	2023年2月27日
一種減少對PCB板熱傳導的QFN封裝結構及其製備方法.....	中國	CN202310432274.7	本公司	發明專利	2023年4月21日
適用於半導體封裝的二維碼讀取裝置.....	中國	CN202320921973.3	本公司	實用新型	2023年4月23日
一種減少溢料的基板結構.....	中國	CN202320409274.0	本公司	實用新型	2023年3月02日
一種能夠優化濾波器產品覆膜效果的封裝結構.....	中國	CN202320701933.8	本公司	實用新型	2023年4月03日
使用矽基支撐結構的晶圓級扇出型封裝結構及其製備方法...	中國	CN202310433234.4	本公司	發明專利	2023年4月21日
一種晶圓級封裝的再處理方法...	中國	CN202310431692.4	本公司	發明專利	2023年4月21日

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
電鍍液自動滴定裝置.....	中國	CN202223606117.3	本公司	實用新型	2022年12月31日
一種耐高壓倒裝芯片的三明治型封裝結構.....	中國	CN202320223721.3	本公司	實用新型	2023年2月15日
通用的倒裝機的金屬吸嘴結構...	中國	CN202320859392.1	本公司	實用新型	2023年4月18日
一種自動識別晶圓圖紙上多餘錫球及去除多餘錫球的方法.....	中國	CN202310410906.X	本公司	發明專利	2023年4月18日
一種測試晶圓及其測試系統.....	中國	CN202223520092.5	本公司	實用新型	2022年12月28日
芯片剝離負壓加熱平台.....	中國	CN202223600004.2	本公司	實用新型	2022年12月30日
芯片導電柱.....	中國	CN202223400104.0	本公司	實用新型	2022年12月16日
包覆型多金屬導電凸塊結構...	中國	CN202221949012.5	本公司	實用新型	2022年7月26日
晶圓切割刀片.....	中國	CN202223111526.6	本公司	實用新型	2022年11月22日
電鍍機連接線接頭	中國	CN202223197621.2	本公司	實用新型	2022年11月30日
一種阻斷式寬口點膠閥.....	中國	CN202223112230.6	本公司	實用新型	2022年11月23日
濾波器模組的封裝結構.....	中國	CN202222463835.3	本公司	實用新型	2022年9月15日
一種封裝後線改善產品翹曲的裝置.....	中國	CN202222513767.7	本公司	實用新型	2022年9月22日

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種封裝後線回流防翹曲真空吸附治具 . . .	中國	CN202222583938.3	本公司	實用新型	2022年9月28日
晶圓倒片裝置.	中國	CN202222848908.0	本公司	實用新型	2022年10月27日
全自動網板清洗機.	中國	CN202222446928.5	本公司	實用新型	2022年9月15日
半導體塑封模具的模流平衡結構 . . .	中國	CN202222479551.3	本公司	實用新型	2022年9月19日
一種封裝後線回流防翹曲裝置.	中國	CN202221986949.X	本公司	實用新型	2022年7月29日
自動調整產品位置的防呆裝置.	中國	CN202222656709.X	本公司	實用新型	2022年10月09日
集成電路芯片封裝結構.	中國	CN202222504241.2	本公司	實用新型	2022年9月21日
一種植球裝載清潔裝置.	中國	CN202222159352.4	本公司	實用新型	2022年8月16日
一種具有高密度連接層的芯片封裝方法及其芯片封裝結構	中國	CN202211179108.2	本公司	發明專利	2022年9月27日
倒裝芯片封裝結構	中國	CN202222063451.2	本公司	實用新型	2022年8月05日
一種可實現防止分層的多圈凹槽框架及其芯片封裝結構	中國	CN202221011731.2	本公司	實用新型	2022年4月28日

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種抽檢防呆裝置	中國	CN202221958896.0	本公司	實用新型	2022年7月27日
一種可防反料盒夾取系統.....	中國	CN202123287634.4	本公司	實用新型	2021年12月24日
一種背膠全自動擦片設備.....	中國	CN202222197408.5	本公司	實用新型	2022年8月19日
全自動錫球焊劑供料櫃.....	中國	CN202221613513.6	本公司	實用新型	2022年6月23日
一種晶圓刻號打印輔助治具...	中國	CN202221950431.0	本公司	實用新型	2022年7月27日
一種增強結合力的晶圓級芯片封裝結構.....	中國	CN202221511859.5	本公司	實用新型	2022年6月16日
一種全自動抽檢器.....	中國	CN202221524956.8	本公司	實用新型	2022年6月17日
一種防呆配件.....	中國	CN202221943994.7	本公司	實用新型	2022年7月26日
一種接觸感應式貼片機墊塊結構.	中國	CN202221210823.3	本公司	實用新型	2022年5月18日
一種增加散熱提升電磁屏蔽的芯片封裝結構.....	中國	CN202221608099.X	本公司	實用新型	2022年6月24日
一種可減少跨線增大打線空間的封裝框架.....	中國	CN202221488597.5	本公司	實用新型	2022年6月14日
一種封裝基板結構	中國	CN202221530359.6	本公司	實用新型	2022年6月17日

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種QFN封裝結構的固定裝置.....	中國	CN202220386403.4	本公司	實用新型	2022年2月24日
芯片封裝結構.....	中國	CN202222145491.1	本公司	實用新型	2022年8月16日
一種倒裝芯片封裝結構.....	中國	CN202221235259.0	本公司	實用新型	2022年5月20日
半導體封裝結構...	中國	CN202222091385.X	本公司	實用新型	2022年8月10日
一種可實現次品安全去除的檢驗去次機構...	中國	CN202221016034.6	本公司	實用新型	2022年4月28日
一種提高凸塊及再佈線層均勻性的芯片封裝結構.....	中國	CN202220876408.5	本公司	實用新型	2022年4月15日
一種包含實體切割連筋的引線框架.....	中國	CN202221013025.1	本公司	實用新型	2022年4月27日
一種無基島框架的封裝結構.....	中國	CN202221004919.4	本公司	實用新型	2022年4月27日
一種防遺忘的定位架及包括定位架的切割裝置.....	中國	CN202220677276.3	本公司	實用新型	2022年3月24日
一種晶圓級晶片尺寸封裝檢驗換卷貼標裝置...	中國	CN202220550611.3	本公司	實用新型	2022年3月14日
一種雙面封裝結構	中國	CN202220300421.6	本公司	實用新型	2022年2月15日
一種晶圓級芯片封裝結構.....	中國	CN202220656365.X	本公司	實用新型	2022年3月24日

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種可實現過濾功能的膠板結構.....	中國	CN202123082033.X	本公司	實用新型	2021年12月09日
一種增加管腳間隙的引線框架.....	中國	CN202220474953.1	本公司	實用新型	2022年3月04日
一種多芯片濾波器封裝結構.....	中國	CN202123310071.6	本公司	實用新型	2021年12月27日
一種六面包覆的扇出型芯片封裝結構.....	中國	CN202123440565.6	本公司	發明專利	2021年12月31日
一種基於轉接板的多芯片濾波器封裝結構.....	中國	CN202123310060.8	本公司	實用新型	2021年12月27日
一種防止銦片濺射的芯片封裝結構.....	中國	CN202123391212.1	本公司	實用新型	2021年12月31日
自動供液氣液分離藥液回流系統	中國	CN202123218365.6	本公司	實用新型	2021年12月20日
一種半導體器件及測試系統.....	中國	CN202123125358.1	本公司	實用新型	2021年12月13日
一種半導體封裝結構及測試系統.....	中國	CN202123170489.1	本公司	實用新型	2021年12月13日
一種芯片塑封模具	中國	CN202122843347.0	本公司	實用新型	2021年11月18日
半導體濕法設備混合配比集中供液系統...	中國	CN202122822174.4	本公司	實用新型	2021年11月17日

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種引線框架結構	中國	CN202122866577.9	本公司	實用新型	2021年11月22日
一種帶有電磁屏蔽的芯片封裝結構.....	中國	CN202122586612.1	本公司	實用新型	2021年10月26日
一種高密度扇出封裝結構.....	中國	CN202220326220.3	本公司	實用新型	2022年2月18日
一種扇出封裝方法及扇出封裝結構.....	中國	CN202111352295.5	本公司	實用新型	2021年11月16日
一種基於阻隔層的多芯片濾波器封裝結構.....	中國	CN202123314330.2	本公司	實用新型	2021年12月27日
晶圓塗膠熱板傳送示教輔助治具	中國	CN202122367486.0	本公司	實用新型	2021年9月28日

3. 有關董事及監事的進一步資料

董事及監事的合約及委聘函的詳情

我們已與董事及監事各自就以下事項(其中包括)訂立合約：(i)任期，及(ii)終止條款。除上述披露者外，董事或監事並無或不擬與本公司任何成員公司訂立任何服務合約(於一年內到期或可由相關僱主於一年內終止而無需支付賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

董事、監事及高級管理層酬金

除本文件「董事、監事及高級管理層－董事、監事及高級管理層薪酬」一節所披露者外，概無董事及監事於截至2025年12月31日止三個年度各年自本公司收取其他酬金。

所收取代理費用或佣金

[**編纂**]將就[**編纂**]收取[**編纂**]，詳述於「[**編纂**]－[**編纂**]及開支」。除與[**編纂**]有關外，本集團於緊接本文件日期前兩年內並無就本公司或本集團任何成員的任何資本

或證券的發行或銷售向任何人士（包括下文「－其他資料－專家資格及同意」所述的董事、發起人及專家）授出任何佣金、折扣、經紀費用或其他特別條款。

於緊接本文件日期前兩年內，概無就任何認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司任何股份或債權證而已支付或應支付任何佣金。

董事權益披露

緊隨[**編纂**]完成後（假設[**編纂**]並無獲行使且並無計及根據[**編纂**]購股權計劃授予的任何購股權獲行使而將予[**編纂**]的任何股份），我們的董事概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中，擁有[**編纂**]在聯交所[**編纂**]後根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述登記冊的權益及／或淡倉，或根據上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會我們及聯交所的權益及／或淡倉。

			截至最後實際可行日期及緊接[編纂]完成前		緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使且並無計及根據[編纂]購股權計劃授予的任何購股權獲行使而將予[編纂]的任何股份）		
姓名	職位	權益性質	股份數目及描述	佔本公司權益概約百分比	股份數目及描述	佔本公司權益概約百分比[8]	佔[編纂]（視情況而定）概約百分比[8]
張國棟先生.....	董事會主席、執行董事	實益擁有人[1]；於受控法團的權益[4][5]；一致行動人士[6]	239,240,000股非上市股份	24.95%	[**編纂**]	[**編纂**]	[**編纂**]
潘明東先生.....	執行董事	實益擁有人[2]；於受控法團的權益[4][5]；一致行動人士[6]	239,240,000股非上市股份	24.95%	[**編纂**]	[**編纂**]	[**編纂**]
劉怡先生.....	執行董事	實益擁有人[3]；於受控法團的權益[4][5]；一致行動人士[6]	239,240,000股非上市股份	24.95%	[**編纂**]	[**編纂**]	[**編纂**]

附註：

(1) 截至最後實際可行日期，張國棟先生直接擁有本公司股權約5.38%的權益；

(2) 截至最後實際可行日期，潘明東先生直接擁有本公司股權約3.01%的權益；

(3) 截至最後實際可行日期，劉怡先生直接擁有本公司股權約1.04%的權益；

(4) 截至最後實際可行日期，南京寧泰芯企業諮詢管理合夥企業(有限合夥)(「**寧泰芯**」)直接擁有本公司股權約9.49%的權益。根據規管寧泰芯的有限合夥企業協議，張國棟先生為寧泰芯的普通合夥人。作為寧泰芯的普通合夥人，張國棟先生被視為於寧泰芯擁有實際控制權，因而為寧泰芯的控制人。因此，張國棟先生就證券及期貨條例被視為於寧泰芯持有的該等股份中擁有權益；

(5) 截至最後實際可行日期，寧波梅山保稅港區寧浦芯企業管理合夥企業(有限合夥)(「**寧浦芯**」)直接擁有本公司股權約6.02%的權益。根據規管寧浦芯的有限合夥企業協議，張國棟先生為寧浦芯的普通合夥人。作為寧浦芯的普通合夥人，張國棟先生被視為於寧浦芯擁有實際控制權，因而為寧浦芯的控制人。因此，張國棟先生就證券及期貨條例被視為於寧浦芯持有的該等股份中擁有權益；

(6) 根據張國棟先生、潘明東先生、劉怡先生、寧泰芯與寧浦芯訂立日期為2023年6月8日的一致行動人士協議，各方確認(i)彼等應就本公司業務營運及企業管治的決策而相互諮詢並在本公司股東大會或董事會會議上表決前達成共識後一致投票，及(ii)當各方未能達成一致時，各方應遵守張國棟先生的指示。因此，張國棟先生、潘明東先生、劉怡先生、寧泰芯及寧浦芯持有本公司已發行股本合共約24.95%，並為一致行動人士。彼等亦被視為本公司的單一最大股東集團；及

(7) 計算乃根據假設(i)[**編纂**]將[**編纂**]為H股；(ii)[**編纂**]並無獲行使；及(iii)並無計及根據[**編纂**]購股權計劃授予的任何購股權獲行使而將予發行的任何股份；及(iv)緊隨[**編纂**]完成後的已發行股份總數將為[**編纂**]股股份。

除本文件「主要股東」所披露者外，緊隨[**編纂**]完成及將[**編纂**][**編纂**]為H股後，董事並不知悉任何其他人士將於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益及／或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下於本公司或本公司任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

主要股東權益披露

有關緊隨[**編纂**]完成後將於我們的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向我們及聯交所披露的權益或淡倉的人士的資料，請參閱「主要股東」一節。

主要股東於本公司非全資附屬公司的權益

我們的附屬公司	註冊資本	擁有10%或以上股權的一方（本集團成員公司除外）	概約股權百分比
揚州芯粒.....	人民幣820百萬元	揚州龍投芯粒半導體產業投資基金合夥企業(有限合夥)	71.95%

就上文所載，董事並不知悉任何人士(董事或監事除外)將於緊隨[**編纂**]完成後直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下於本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

4. 其他資料

[編纂]購股權計劃

本公司已採納[**編纂**]購股權計劃，該計劃已於2025年10月13日獲股東批准。根據[**編纂**]購股權計劃，[**編纂**]前可向合資格參與者授出最多[**編纂**]份購股權，佔本公司緊接[**編纂**]前股本總額的[**編纂**]%。行使購股權後，本公司將以發行H股的方式結算，惟須符合上市規則的相關規定。以下為[**編纂**]購股權計劃的主要條款概要：

目的

[**編纂**]購股權計劃旨在進一步完善本公司長期的激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分激勵董事、高級管理層、關鍵管理人員、核心技術或業務人員，有效協調股東、本公司及核心團隊的利益，並按照「貢獻與回報」的原則促進本公司的可持續發展。

合資格參與者

合資格[**編纂**]購股權計劃的人士(「**參與者**」)包括董事、高級及關鍵管理人員、核心技術及業務人員，及曾為或預期將對本公司的成長發展作出重大貢獻的其他僱員，以及董事會認為有必要納入[**編纂**]購股權計劃的其他僱員。[**編纂**]購股權計劃共有38名參與者參與。

管理

[**編纂**]購股權計劃的批准、變更或終止均須股東大會通過，我們的董事會獲授權實施[**編纂**]購股權計劃。

行使價

購股權的行使價為[**編纂**]人民幣[**編纂**]元，不低於本公司截至2024年12月31日的經審核每股資產淨值。倘發生資本化發行、紅股發行、分拆、合併、供股、股息分派等情況，行使價將進行調整。

歸屬及行使期

[**編纂**]購股權計劃自授予登記日期起60個月內有效，直至所有已授出購股權獲行使或註銷。未行使購股權將於行使期屆滿後自動失效。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

根據[**編纂**]購股權計劃授出的購股權自授出日期起計有24個月的禁售期，可分三期行使。具體而言，30%的購股權將於授予登記後第24個月至第36個月可行使；40%購股權於第36個月至第48個月可行使；餘下30%購股權將於授予登記後第48個月至第60個月可行使。

失效

倘參與者辭任、解僱、退任、不稱職或違反相關責任，則授予該參與者但尚未行使的所有獎勵應立即停止行使，並由本公司註銷。

授予購股權詳情

於2025年11月，已根據計劃向38名參與者授出合共[**編纂**]份購股權，佔緊隨[**編纂**]後本公司已發行股本總額的[**編纂**]%。

根據[**編纂**]購股權計劃於[**編纂**]前將予授出的購股權詳情載列如下：

姓名	地址	每股行使價	尚未行使購股權涉及的股份數目	佔緊隨[編纂]完成後已發行股份概約百分比
		(人民幣元)		
高級管理層				
方亞萍女士.....	中國江蘇省江陰市石山路龍禧花園66號樓102室	[**編纂**]	[**編纂**]	[**編纂**]
小計			[**編纂**]	[**編纂**]
其他核心管理層及關鍵技術人員				
小計			[**編纂**]	[**編纂**]
未行使購股權總數			[**編纂**]	[**編纂**]

遺產稅

董事獲悉，根據中國法律，本公司或本集團任何其他成員公司不大可能須承擔重大遺產稅責任。

訴訟

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，本集團任何成員公司概無涉及任何重大訴訟或仲裁，董事亦不知悉由或向本集團任何成員公司作出的任何待決或面臨的重大訴訟或申索。

獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向聯交所[**編纂**][**編纂**]批准本文件所提及將予[**編纂**]的所有[**編纂**][**編纂**]及[**編纂**]。獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則。

根據本公司與獨家保薦人訂立的委聘函，我們同意向獨家保薦人支付費用0.6百萬美元，作為就建議於聯交所[**編纂**]擔任本公司的保薦人。

合規顧問

本公司已遵守上市規則第3A.19條於[**編纂**]後委任華富建業企業融資有限公司為其合規顧問。

開辦開支

截至最後實際可行日期，本公司並無產生任何重大開辦開支。

發起人

本公司的發起人為心聯芯、南京元鈞及寧泰芯。有關本公司發起人的詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」一節。

除[**編纂**]及本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[**編纂**]及本文件所述的相關交易向上述名列的任何發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券、金額或其他利益。

專家資格

本文件所載或提述提供意見或建議的專家資格如下：

專家名稱	資格
華泰金融控股(香港)有限公司	根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第3類(槓桿式外匯交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)、第7類(提供自動化交易服務)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團
安永會計師事務所	執業會計師兼註冊公眾利益實體核數師
江蘇世紀同仁律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司	獨立行業顧問
安睿順德倫國際律師事務所	本公司有關國際制裁及出口管制法律的法律顧問

專家同意

本附錄「－4.其他資料－專家資格」一段所述專家已各自就本文件的刊發發出書面同意，同意按本文件所示格式及內容，轉載其報告及／或函件及引述其名稱，且並無撤回該等書面同意。

概無上文所名列專家於本公司任何成員公司擁有任何股權權益或權利（不論是否可強制執行）以認購或提名他人認購本公司任何成員公司的證券。

約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，使全部有關人士須受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條的所有適用條文（罰則條文除外）所約束。

雙語文件

本文件的中英文版本根據香港法例第32L章《公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第4條規定的豁免分開刊發。

並無重大不利變動

董事確認，直至本文件日期，本集團的財務或貿易狀況或前景自2025年12月31日（即編製本集團最近期綜合財務報表的日期）起概無重大不利變動。

H股持有人的稅項

出售、購買及轉讓在香港股東名冊分冊中登記的H股均須繳納香港印花稅。就每名買方及賣方收取的現行費率為所出售或轉讓股份的對價或公平值（以較高者為準）的0.1%。有關稅項的進一步詳情，請參閱本文件附錄三。

其他事項

(i) 除「歷史、發展及公司架構」所披露者外，於本文件日期前兩年內，概無發行或同意發行繳足或部分繳足的本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本以換取現金或現金以外代價；

(ii) 概無本公司股份或借貸資本（如有）附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權；

(iii) 本公司或其任何附屬公司概無已發行或同意發行任何發起人、管理層或遞延股份；

(iv) 本公司目前並無於任何證券交易所上市或於任何交易系統買賣；

(v) 本公司並無任何發行在外的可換股債務證券或債權證；

(vi) 除有關[**編纂**]外，本節「－專家資格」所列專家概無於本集團任何成員公司的股份擁有實益或非實益權益或擁有權利或購股權（不論是否法律上可強制執行）以認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券；

(vii) 本文件的中英文版本中，概以英文版本為準；

(viii) 於本文件日期前12個月我們的業務並無出現可能對或已經對我們財務狀況構成重大影響的任何中斷情況；及

(ix) 我們並無訂立放棄或同意放棄未來股息的安排。